

smthybridpackaging

Internationale Fachmesse und Kongress
für Systemintegration in der Mikroelektronik

Nürnberg, 05. – 07.06.2018
smthybridpackaging.de

Forenprogramm *Forum Program*

Messeforum, Halle 4, Stand 4-520 *Exhibition Forum, hall 4, booth 4-520*

Dienstag, 05.06.2018 *Tuesday, 05 June 2018* *Seite 2 Page 2*

Mittwoch, 06.06.2018 *Wednesday, 06 June 2018* *Seite 3 Page 3*

Donnerstag 07.06.2018 *Thursday 07 June 2018* *Seite 4 Page 4*

ZVEI-Forum Halle 4A, Stand 4A-400 *ZVEI-Forum, hall 4A, booth 4A-400*

Dienstag, 05.06.2018 *Tuesday, 05 June 2018* *Seite 5 Page 5*

Mittwoch, 06.06.2018 *Wednesday, 06 June 2018* *Seite 5 Page 5*

Donnerstag 07.06.2018 *Thursday 07 June 2018* *Seite 5 Page 5*

smthybridpackaging

Messeforum Halle 4, Stand 4-520

Exhibition Forum hall 4, booth 4-520

Dienstag, 05.06.2018 *Tuesday, 05 June 2018*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
Podiumsdiskussion / Panel discussion			
10:00 - 10:30	Global SMT & Packaging	Trevor Galbraith	Smart Factory integration
10:30 - 11:00	Global SMT & Packaging	Trevor Galbraith	Is the industry ready for Artificial Intelligence?
Produktpräsentationen / Vendor Presentations			
11:00 - 11:20	Indium Corporation	Andreas Karch	„Moderne Lotpasten lösen Aufgaben der Miniaturisierung (Verarbeitung von 01005 und kleiner)“
11:20 - 11:40	Accumold	Aaron Johnson	The 5 Essentials for Micro Molding
11:40 - 12:00	GÖPEL electronic GmbH	Jens Kokott	MagicClick: Der kurze Weg zum AOI-Programm...
Fachvortrag / Specialist lecture			
12:00 - 12:30	Fraunhofer IZM	Ulf Oestermann	„Intelligente Automation für E-Mobilität und Robotik“
12:30 - 13:00	Bob's Willis - Bobwillis.co.uk	Bob Willis	Reflow Defect Elimination - How to solve process problems with video simulation
Produktpräsentationen / Vendor Presentations			
13:00 - 13:20	Kulicke & Soffa	Marco van Oosterhout	Challenges in Advanced Packaging within SMT manufacturing
13:20 - 13:40	ASSCON Systemtechnik-Elektronik GmbH	Axel Wolff	„Vakuum Löten – Best Praxis Qualität mit Clean Vakuum Technology“
13:40 - 14:00	Nordson DAGE	Russell Byrne	Nordson DAGE : The future of advanced, high precision inspections systems. Where to next?
Fachvortrag / Specialist lecture			
14:10 - 14:25	WNIE + FLITE	Kim Sauer	SMART-Factory evolution
14:30 - 14:45	WNIE + FLITE	Kim Sauer	The 'Circular Economy' and the electronics manufacturing industry
Produktpräsentationen / Vendor Presentations			
14:50 - 15:10	Mycronic GmbH	James Denner	Die neue MYSmart Serie, das erweiterte Mycronic Portfolio von Dosier- und Conformal-Coating-Systemen für die SMT Fertigung.
15:10 - 15:30	Indium Corporation	Karthik Vijay	Automotive-grade Solder Paste for Enhanced Electrical Reliability & Low Voiding

smthybridpackaging

Messeforum Halle 4, Stand 4-520

Exhibition Forum hall 4, booth 4-520

Mittwoch, 06.06.2018 *Wednesday, 06 June 2018*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
Podiumsdiskussion / Panel discussion			
10:00 - 10:30	Global SMT & Packaging	Trevor Galbraith	A multidisciplinary approach to void reduction
10:30 - 11:00	Global SMT & Packaging	Trevor Galbraith	Integrated test methodologies - making x-ray intelligent
11:00 - 12:00	Productronic, Hüthig Verlag	Marisa Robles Consée	Digitalisierung in der automatischen Baugruppeninspektion
Fachvortrag / Specialist lecture			
12:00 - 12:30	Fraunhofer IZM	Ulf Oestermann	„Intelligente Automation für E-Mobilität und Robotik“
Produktpräsentationen / Vendor Presentations			
12:30 - 12:50	ZESTRON Europe a business division of Dr. O.K. Wack Chemie GmbH	Dr. Helmut Schweigart	Schadensfälle erkennen und vermeiden
12:50 - 13:10	Alpha Assembly Solutions Germany GmbH	Ralph Christ	Introduction to Low Temperature Soldering
13:10 - 13:30	IMAGO Technologies GmbH	Dipl. Ing. Carsten Strampe	„New Deep Learning Vision Sensor For Assembly Control“
13:40 - 14:00	Accumold	Aaron Johnson	The 5 Essentials for Micro Molding
14:00 - 14:20	Hilpert electronics AG	Patrick Greuter	Zuverlässig, wartungsarm, langlebig: Lötöfen von HB Automation
14:20 - 14:40	FELDER GMBH Löttechnik	Udo Grimmer-Herklotz	Lotpasten im Wandel der Anforderungen
14:40 - 15:00	GÖPEL electronic GmbH	Andreas Türk	Flexible 2D-/3D-Röntgenprüfung einseitig und beidseitig bestückter Leiterplatten in der Linie
15:10 - 15:30	Plasmatreat GmbH	Nico Coenen	Applications in Electronics with Openair-Plasma
15:30 - 15:50	AIM Solder	Petr Bettinec	The development of high reliability lead free alloys
15:50 - 16:10	Nordson EFD	Julian Greiner	Berührungslose Dosierung von Lotpasten – Nordson EFD stellt die neueste Technologie für Elektronikmontageprozesse vor

smthybridpackaging

Messeforum Halle 4, Stand 4-520

Exhibition Forum hall 4, booth 4-520

Donnerstag, 07.06.2018 *Thursday, 07 June 2018*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
Podiumsdiskussion / Panel discussion			
10:00 - 10:30	Global SMT & Packaging	Trevor Galbraith	Will Augmented Reality and Virtual Reality change the face of EMS manufacturing?
10:30 - 11:00	Global SMT & Packaging	Trevor Galbraith	Stencils and avoiding printing defects?
Fachvortrag / Specialist lecture			
11:00 - 11:15	WNIE + FLITE	Kim Sauer	Electronics Manufacturing Supply Chain in Focus: Germany
11:20 - 11:35	WNIE + FLITE	Kim Sauer	What's New in Electronics? Trends & emerging technologies
11:40 - 12:10	FLITE	Kim Sauer	Gender disparity is so universal that we often do not even see it. If we do not see it, how do we achieve parity?
Produktpräsentationen / Vendor Presentations			
12:10 - 12:30	Optimum datamanagement solutions GmbH	Wolfgang Mahanty	Die Schattenseite der Prozesse Wie komme ich zur GAE in der manuellen Fertigung?
12:30 - 12:50	HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH	Gunter Mößinger	Schadensanalytik und Warenbewertung an elektronischen Baugruppen und Bauteilen
Fachvortrag / Specialist lecture			
12:50 - 13:10	beratungsgruppe wirth + partner	Stefan Wirth	Bewerbung strategisch angehen
Produktpräsentationen / Vendor Presentations			
13:10 - 13:30	Hilpert electronics AG	Manfred Vogel	«SET Flip Chip Bonder – Anwendungen für Entwicklung und Produktion»
Fachvortrag / Specialist lecture			
13:30 - 13:50	Yxlon International	Keith Bryant	Advances in 2D and 3D (CT) X-Ray Inspection for Harsh Environments
Produktpräsentationen / Vendor Presentations			
13:50 - 14:10	Adeon Software House	Jan Keijzer	Fast and accurate quotation generation; a "must" for every EMS provider
Preisverleihung Handlötettbewerb / Prize ceremony Hand Soldering Competition			
14:15 - 14:45	Mesago Messe Frankfurt GmbH, IPC	Lars Wallin	

smthybridpackaging

ZVEI-Forum Halle 4A, Stand 4A-400

ZVEI-Forum hall 4A, booth 4A-400

Dienstag, 05.06.2018 *Tuesday, 05 June 2018*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
Podiumsdiskussionen ZVEI / Panel Discussions ZVEI			
11:00 - 11:30	Viscom AG	Markus Möller	Intelligente SMT-Prozessoptimierung durch vernetzte Inspektionssysteme
11:30 - 12:00	LACROIX Electronics Willich	Frank Weiss	Smart Industrie Visions for the next 10 Years
12:00 - 12:30	GÖPEL electronic GmbH	Andreas Türk	Von BGA bis QFN - vollautomatische 2D, 2.5D, 3D Röntgeninspektion in der Praxis
12:30 - 13:15	Murata Europe	Alexander M. Schmoltdt	Creating the Backbone of Electronics Industrie 4.0: Blueprint of an RFID enhanced SMT-Line created by the group RFID in der SMT (RiS)
Fördermittel-Tage / Information days about subsidies			
13:15 - 14:15	Bundesverband deutscher Fördermittel-Berater e.V.	Prof. Klaus Weiler	Wie unterstütze ich mit Zuschüssen, Fördermitteln und Subventionen meine Unternehmensfinanzierung?

Mittwoch, 06.06.2018 *Wednesday, 06 June 2018*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
Podiumsdiskussionen ZVEI / Panel Discussions ZVEI			
11:00 - 12:00	Robert Bosch Vacuumschmelze	Dr. Marc Nikolussi Harald Hundt	Bauteilsauberkeit
12:00 - 13:30	Fujitsu Eltroplan Zollner Elektronik Melecs EWS	Raimund Landsbeck Gustl Keller Mathias Marchner Dr. Georg Loisel	Services in EMS Initiative: Dienstleistungen backstage – Mehrwert unter dem Radar Moderation: Michael Velmeden, cmc electronics 1. Backstage Dienstleistungen - Mehrwert unter dem Radar 2. Product Compliance 3. Datenaufbereitung: Integration von externen Komponentendaten in die Systemlandschaft von Zollner 4. Validierung und Requalifizierung
13:30 - 15:00	Cicor Advanced Microelectronics & Substrates Division - Reinhardt Microtech GmbH VIA electronic GmbH Turck Duotec GmbH Robert Bosch GmbH	Dr. Alexander Kaiser Franz Bechtold Bernd Thyzel Dr. Josef Weber	Erfolgslösungen mit Keramik Basistechnik für elektronische Mikrosysteme Einführung und Motivation: Dirk Schönherr, Lust Hybrid-Technik 1. Aktuelle Technologien und Packaging-Lösungen mit Dünnschichtsubstraten 2. Keramische Integrations- und Packaging Lösungen für Sensoren mit herausragenden Leistungsmerkmalen 3. Dickschichtdruck auf amorphen Substraten – Prozesse und Applikationen 4. Technologien und Applikationen
Fördermittel-Tage / Information days about subsidies			
15:00 - 16:00	Bundesverband deutscher Fördermittel-Berater e.V.	Prof. Klaus Weiler	Wie unterstütze ich mit Zuschüssen, Fördermitteln und Subventionen meine Unternehmensfinanzierung?

Donnerstag 07.06.2018 *Thursday 07 June 2018*

Uhrzeit <i>Time</i>	Firma <i>Company</i>	Referent <i>Speaker</i>	Thema <i>Topic</i>
Fördermittel-Tage / Information days about subsidies			
11:00 - 12:00	Bundesverband deutscher Fördermittel-Berater e.V.	Prof. Klaus Weiler	Wie unterstütze ich mit Zuschüssen, Fördermitteln und Subventionen meine Unternehmensfinanzierung?